

FPC-13 型高稳定耐高温硅压阻式压力芯体

特 点

- 进口 SOI 高温压力芯片
- 宽温度补偿与零点偏差修正
- 耐高温，高性能，高稳定性
- 18 个月质保期

概 述

FPC-13 型高稳定耐高温硅压阻式压力芯体，选用进口高稳定扩散硅芯片，采用厚膜电路进行宽温度补偿和零点偏差修正，通过严格的检验和筛选，广泛应用于各种高稳定性要求的压力测量场合。



技术性能

电桥电阻	3K Ω ~6K Ω
供电电源	恒流 1.5mA、恒压 10V
使用温度	-55 $^{\circ}$ C ~125 $^{\circ}$ C, -55~150 $^{\circ}$ C, -55~200 $^{\circ}$ C
补偿范围	-10 $^{\circ}$ C ~70 $^{\circ}$ C (可选)
壳体和膜片	不锈钢 316L
精 度	0.25%FS (典型)
零 点	± 2 mV
满 量 程	≥ 100 mV (1.5mA 供电)
零点温漂	0.02%FS/ $^{\circ}$ C
灵敏度温漂	0.02%FS/ $^{\circ}$ C
绝 缘	100M Ω /250VDC
密 封 圈	丁晴或氟橡胶
长时间稳定性	0.2%FS/年
充 油	硅油、橄榄油、氟油
响应时间	≤ 1 ms (上升到 90%FS)
振 动	20g/ (20~5000Hz)
耐用性周	100 $\times$ 106%FS

量程选择

G 表压 (通气式表压, 以当前大气压为零点) 单位: MPa

量程	-0.1~0	-0.035~0	-0.02~0	0.02	0.035	0.07	0.1
过载%	300	3000	300	300	300	300	200
量程 MPa	0.16	0.25	0.4	0.6	1.0	1.6	2.5
过载%	200	200	200	200	200	200	200

A 绝压 (真空为零点) 单位: MPa

量程	0.1	0.25	0.4	0.6	1.0	1.6
过载%	200	200	200	200	200	200

S 密封式表压 (校准大气压为零点) 单位: MPa

量程	1.0	1.6	2.5	6	10	25	40	60	100
过载%	200	200	200	200	200	150	150	150	150